



AirJet® Mini G2

强大的人工智能需要与之匹配的散热解决方案。

热量是计算领域的最大瓶颈，随着先进人工智能模型的兴起，这一问题愈发严重。人工智能推理任务需要持续的高性能，而非仅仅是短暂的爆发。这意味着更多的运算、更多的热量……以及对下一代散热解决方案的迫切需求。

隆重推出 AirJet Mini G2——全球最薄且功能最强大的固态主动散热芯片。由 Frote Systems 研发，AirJet 是一款革命性的、完全独立的主动散热模块。AirJet Mini G2 可移除 7.5 瓦的热量，具备静音、纤薄、轻巧、防尘、无振动、防水的特性，性能优于风扇。

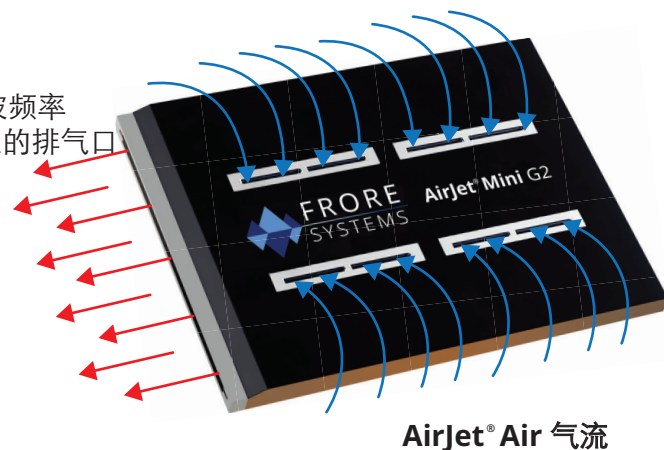
专为当今最热门的设备而打造——从二合一平板电脑到 5G 热点——**AirJet Mini G2** 将散热转化为战略优势。

革命性的固态散热

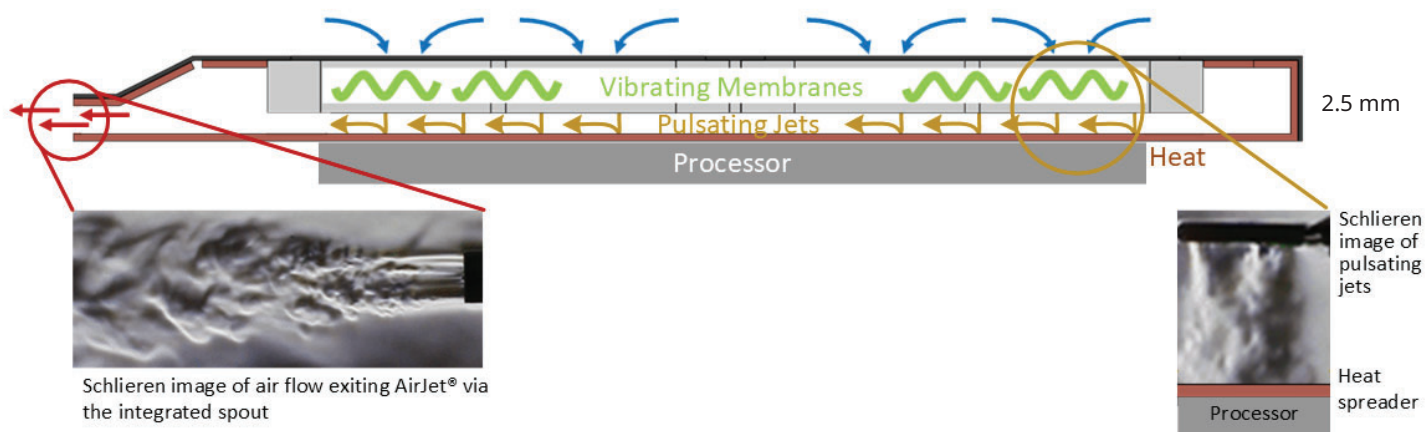
与风扇不同，AirJet 没有移动部件。芯片内部 MEMS 膜片以超声波频率震动产生高速脉冲气流吸入空气饱和热量。然后通过主机设备上的排气口将热量排出——而这一切都发生在一个仅 2.5 毫米厚的模块中。

静音。防尘。无振动。

AirJet Mini G2 提供毫不衰减的卓越性能。



AirJet 模块横截面



AirJet® Mini G2

开创性设计

AirJet 的多物理场设计融合了结构、流体、声学 and 电共振。AirJet 采用源自半导体、平板显示、航空航天和汽车等多个领域的专有技术制造。

工作原理

在现代计算中，限制性能的是热量，而非处理器的能力AirJet Mini G2 扭转了这一局面，确保紧凑型电子设备能够实现满负荷性能。

微小芯片，强大背压

AirJet Mini G2 可产生 1750 帕斯卡的背压，此强度足以将空气吸入最紧凑的外壳，即使是在坚固的嵌入式系统中也不例外。

灰尘？水？不在话下

AirJet Mini G2 高达 1750 帕斯卡的背压，能够将空气吸入超紧凑的主机设备，即便是配有防尘防水滤网的设备也能做到。该系统还经过专门设计，可安全排出进入 AirJet 的任何颗粒，不会造成堵塞或性能下降。

精巧设计，无限可能

AirJet Mini G2 仅 2.5 毫米厚、7 克重。这种超薄外形为追求在紧凑设计中更高性能的制造商开辟了新可能。

AirJet Mini G2 可提升各类超薄设备的性能 —— 从笔记本电脑、平板电脑、智能手机到固态硬盘（SSD）、迷你电脑，乃至海量消费级和工业物联网设备 —— 覆盖数据中心、国防、汽车等多元市场。

AirJet Mini G2 提供全球顶级的固态主动散热。以下是相关数据——无与伦比的散热性能，超薄的尺寸：

指标	AirJet® Mini G2
散热性能参数 (芯片温度 85° C，环境温度 25° C 时)	7.5 W
最大噪音 (设备内部，距离 50 厘米处)	21 dBA
最大功耗	1.2 W
背压	1750 Pa
尺寸 (宽 × 长 × 厚度)	26.6 x 41.25 x 2.5mm
重量	7 g

纤薄 静音 更高性能

在消费电子领域，一台 11.7 毫米厚的 14 英寸笔记本电脑，在静音模式下，其处理器持续功率的散热极限为 12 瓦。同一款 11.7 毫米厚的笔记本电脑搭载 4 个 AirJet Mini G2 模块升级后，不止支持 24 瓦的处理器持续功率，并且在保持静音运行的情况下，能让处理器性能提升 100%。

工业边缘设备

同样，在机器视觉相机等工业边缘设备中，AirJet Mini G2 显著提升相机图像质量。将传感器温度从 48°C 降至 15°C，可满足 AI 推理模型快速响应所需的更快处理速度。

Frore 定律的实践

Frore Systems 正通过 Frore 定律推动散热技术的创新——这份雄心勃勃的技术路线图承诺每两年实现散热性能翻番。

更高性能、无噪音、无振动、无风扇。
AirJet——Frore Systems 出品，成就更多。